



Alchimer 籌資 1000 萬美元用於加強全球客戶支援及推展新智慧財產權開發

這筆資金能夠幫助供應商充份滿足市場對矽穿孔互連三維封裝所需的濕式沉積製程不斷成長的需求

美國商業資訊法國 Massy 消息——

Alchimer S.A. 是質優價廉的濕式沉積製程的領導廠商，其產品用於先進的三維封裝應用中的互連。公司今日宣佈新近獲得 1000 萬美元的融資資金，將用於加強客戶支援專案，以及推展新智慧財產權（IP）的開發。

Alchimer 的第 4 輪融資來源既包括一些原有的投資人，也有一些新的投資人，如 AGF 保險公司、法國原子能總署投資公司（CEA Investissement）和 Emertec Gestion 等。

法國格勒諾布爾 Emertec Gestion 的普通合夥人 Jean-Philippe Stefanini 表示：「我們期待 Alchimer 為三維封裝技術做出重大貢獻，並對下一代設備產生重要的影響。Alchimer 與我們的營運模式十分契合，而且我們對其經驗豐富的管理團隊具有充分的信心。」

Alchimer 的 CEO Steve Lerner 表示：「投資人的鼎力支援，尤其是在當前困難的經濟形勢下，是 Alchimer 堅持技術創新的堅實基礎，同時也顯示 Alchimer 的電接枝（electrografting）技術以其強化製程和降低成本的特點，對三維市場的發展興起了積極的推動作用。」

Alchimer 最近宣佈透過矽穿孔（TSVs）增強銅晶種金屬化的 eG ViaCoat 製程，矽穿孔的作用是實現先進三維封裝應用中的互連。這種結構通常比較狹長，較高的寬高比給薄膜的均勻沉積帶來許多難題。eG ViaCoat 製程使用化學品在薄膜上形成沉積，其均勻度能夠達到甚至超過標準的產業品質指標。除了具有若干製程上的優勢之外，這種濕式（wet）法還允許在舊式電鍍設備上實施 eG ViaCoat，從而避免了翻新或改裝的麻煩。

此外，Alchimer 還宣佈已與日本的技術行銷公司 Nagase & Co. Ltd. 簽署了一項協議。Nagase 具有深厚的化學品、塑膠和電子產品背景，根據協議，它將幫助 Alchimer 滿足主要的日本客戶不斷擴大的需求。這進一步說明，作為 TSV 銅晶種和相關薄膜的一種低價替代品，公司的產品正逐步被市場接受。

Lerner 表示：「Nagase 將使我們在化學品和電子產品市場享受到合作的優勢，並將為我們的日本客戶提供優質的支援服務。」

公司同時宣佈，已經聘請經驗豐富的業界資深人士 Kathy Cook 擔任北美地區的業務開發總監。Cook 在半導體產業的製造、銷售和業務發展領域擁有超過 15 年的任職經歷，他曾經服務過的公司有 Applied Materials、Millipore Corp.、ULVAC Technologies 和 SUSS MicroTec 等。

關於 Alchimer S.A

Alchimer 從事創新的化學配方、製程和 IP 的開發和行銷，其產品主要用於奈米薄膜的沉積，可提供半導體互連和三維 TSVs（矽穿孔）。公司的突破性電接枝（eG™）技術是一種電化學製程，能夠在導體和半導體表面產生各種類型的超薄鍍層，Alchimer 總部位於法國的 Massy，是法國原子能總署（Commissariat à l'Énergie Atomique，CEA）的分割資產。

公司於 2001 年正式成立，並於當年獲得法國研發和產業局（French Minister of Research and Industry）頒發的高科技新創公司國家首獎（First National Award）。公司現為歐洲前 100 大具前瞻性公司（Red Herring Top 100 European Company）之一。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式：

SangSok (s.s.) Lee
Lenix Technology Inc.
韓國
電話：+82-31-919-5561
sslee@lenix.co.kr

或

Kathy Cook
Alchimer
業務開發總監
電話：+1 214 649 6153
kathy.cook@alchimer.com

或

Sarah-Lyle Dampoux
Loomis Group
電話：+33 1 58 18 59 30
dampoux@loomisgroup.com